

日本シーバ

ユーザー目線の開発環境を開発・提供

車載SoCの頭脳として DSPコアの採用が拡大 独自システムの開発を支援

日本シーバ
代表取締役社長
日比野 一敬氏



本格的な自動運転時代の到来を前にして、より賢く、安全な自動運転システムの実現を目指す開発が加速してきた。システム中で使われるチップの開発には、自動車メーカー独自のアイデアを思い通りに実装できる開発環境とプロセッサ・コアが欠かせない。2020年、この領域でシーバのDSPコアの採用が急速に拡大したことに、日本シーバ代表取締役社長の日比野一敬氏は大いに期待感を抱く。

——2020年は、例年とは大きく異なる年でした。ビジネスの状況はいかがでしたか。

日比野 幸いなことにコロナ禍の影響はまったく受けず、国内外ともに業績は好調でした。ワールドワイドでは最終的に過去最高の約9500万米ドルの売り上げを見込んでいます。

世界市場では5Gの基地局向けビジネスがとくに好調でした。5Gの基地局大手5社のうち、3社に当社のDSPをライセンスしていただいています。また、これまでの基地局ビジネスは、ノキアやZTEのような川上から川下まですべての要素技術を自前で揃えた大企業しか作れませんでした。OpenRANに基づく5Gでは、特定要素で光る技術を持つ企業も参入できます。この領域に打って出た多くの半導体メーカーにも当社のDSPを

採用いただいています。

その他にも、BluetoothやWi-Fiなどコネクティビティー関連の応用に向けた製品のロイヤリティー収入が大きく伸びました。カメラ、マイクروفोनやモーションセンサーを活用したセンシングの領域も堅調です。

自動運転向け大きく躍進

——日本市場では大変な成果を得られたとお聞きました。

日比野 最も大きなニュースは、世界をリードする車載半導体メーカーであるルネサスエレクトロニクスの次世代車載用SoCで、当社のDSPコア採用を決めていただいたことです。ティア1が開発する世界最大級の自動車メーカー向けプラットフォームに搭載されるチップで、搭載車は2025年に市場投入される予定です。

これまで自動運転車に搭載する中核部のチップには、汎用的なGPUを活用する場合はほとんどでした。しかし今後は、カメラやレーダー、各種センサーなど複雑なシステムを実装していく上で、独自仕様を盛り込んだチップに替わっていきます。当社が自動車市場向けに提供しているDSPベースのソリューションは高度な要件が求められるセンサー処理やAI関連処理を対照にしたものです。今回の採用は、世界市場につながる、とても大きなプロジェクトであり、これからの成長の新基軸となる成果を上げることができました。

——採用されるにあたって、何が評価されたのでしょうか。

日比野 DSPの性能とともに、車載ソフトウェアの開発環境の使い勝手の良さが決め手だったとお聞きしてい

ます。例えばトヨタは、これからクルマを開発する際の方針として、「ソフトウェアファースト」を強調していました。そして自動運転車向けソフトウェアを開発する新会社「トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスド・デベロップメント(TRI-AD)」を設立し、「Arene」と呼ぶ自動運転の開発プラットフォームを作る構想を公表していました。このような自動車産業界に対してシーバの「CDNN-Invite」は、当社のDSPだけでなく、お客様が開発したアクセラレーターも含めてサポートでき、その有用性を納得していただきました。

——売り上げへの貢献はいつ頃からなるのでしょうか。

日比野 ライセンスは2020年の第3四半期から売り上げとなり、ルネサス製のチップが複数シリーズで投入されるにつれて続々と供与していきます。そして2025年からはロイヤリティー収入を得ることになります。さらにこれからは国内外の自動車メーカーにも展開していく予定です。

——日本の自動車業界では、半導体チップの仕様決定には、半導体メーカー

側よりも自動車メーカー側の意向がより尊重されるように思えます。日本固有の環境に合わせた顧客開拓をしてきたのでしょうか。

日比野 確かに、海外市場では、DSPの直接の採用者である半導体メーカーを対象にして、自社の強みをアピールするのが一般的です。ただし、利用するDSPの違いは自動車メーカーが開発するソフト開発環境、ひいてはクルマの価値にも大きく影響しますから、自動車メーカー主導での選択には一定の合理性があると思います。当社としては、郷に入れば郷に従えて、日本では自動車メーカーに当社のDSPが納得できるメリットを持っていることを知っていただくことが重要だと考えました。もちろん自動車メーカーが半導体メーカーに特定のDSPコアの採用を迫るようなことはありませんが、支持や理解されているコアは半導体メーカーも採用しやすいことは確かでしょう。

——日本に拠点を置くならでの動きができたということですね。今後はさらに、日本の自動車業界との結びつきが深くなりそうですね。


日比野 ありがたいことに、おっしゃるとおりです。私たちは自動車、ロボット、カメラの市場を、日本企業がイノベーションの最前線に立つとても重要な市場と見ています。そして、コンピュータビジョン、AI、サウンド、モーションセンシング、ワイヤレス・コネクティビティーの最先端技術とロードマップを日本のお客様に提供することに強くコミットしています。これを実現するために日本シーバ内にR&Dセンターを開設することで、日本のお客様の要求仕様に合った開発を進めていきます。まずはイメージング、コンピュータビジョン、AI、SLAMの分野で、世界中のR&Dチームと協力して高度なアルゴリズムやソフトウェアを開発していきますので、経験のあるエンジニアを募集しています。

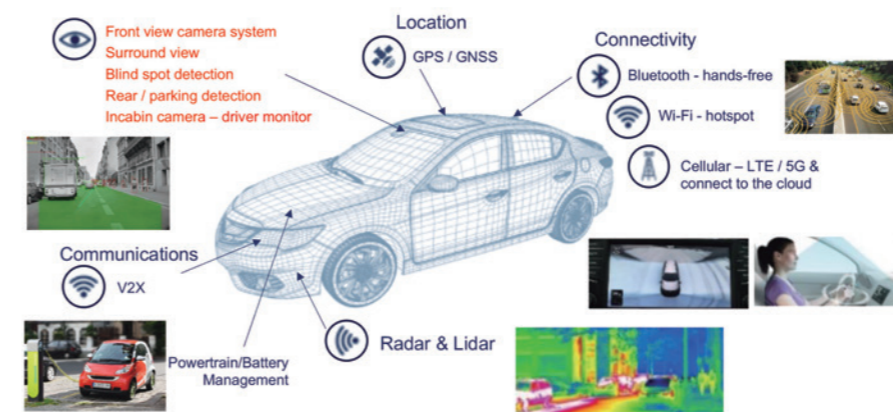
——2021年には、どのような領域に注力していくのでしょうか。

日比野 2020年に、自動車業界に参入させていただいたので、ここで開発を確実に進めてお客様の仕事の成功を支えることこそが、何より重要だと考えています。自動車関連は引き続き拡大していきます。

他にも、デジカメ向けSoCでは、ちょうど新世代に移行するタイミングに当たるため作り変えの案件が出てくると期待しています。加えて、日本においても5G関連での受注を目指していきたいと考えています。

——ユーザーや読者に向けてメッセージをお聞かせください。

日比野 2021年、当社は地道にお客様が求める製品を作っていく年になることでしょう。私たちを選んでいただいたお客様の期待に応え、安心・納得するような製品・サービスを確実に提供していきたいと思いを。 



シーバが手掛ける車載用システム



日本シーバ株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル3階 TEL: 03-5774-8250
URL: <https://www.ceva-dsp.com/>